

## Leistungsbeschreibung

### „Rahmenvereinbarung für Unterstützungsleistungen für MPW-Shuttle und Prototyping Services“



Leibniz Institute  
for High  
Performance  
Microelectronics

**Vergabenummer IHP-2026-028**

#### Auftraggeber:

**IHP GmbH – Leibniz Institute for High Performance Microelectronics/  
Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik  
Im Technologiepark 25  
15236 Frankfurt (Oder)**

Die IHP GmbH schreibt Unterstützungsleistungen im Rahmen ihrer MPW-Shuttle- und Prototyping-Services aus.

Gegenstand der Ausschreibung ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von zwei (2) Jahren. Der Auftraggeber behält sich vor, die Rahmenvereinbarung zweimal um jeweils zwölf (12) Monate zu verlängern. Die maximale Gesamtlaufzeit beträgt somit vier (4) Jahre. Im Rahmen dieser Vereinbarung können während der Vertragslaufzeit Leistungen bedarfsabhängig über Einzelabrufe (Call-offs) beauftragt werden. Ein Anspruch auf eine Mindestabnahme besteht nicht.

Die Leistungen sind in drei voneinander unabhängige Lose gegliedert. Eine Angebotsabgabe ist für einzelne oder mehrere Lose möglich.

Zu jedem Los gehört eine separate Excel-Tabelle mit detaillierten Leistungspositionen. Diese ist vollständig auszufüllen und Bestandteil des Angebots. Unvollständig ausgefüllte Unterlagen können zum Ausschluss des Angebots führen.

---

## Los 1: Maskensupport und Auftragslogistikmanagement

### Leistungsgegenstand

Unterstützung der IHP GmbH bei der organisatorischen und logistischen Abwicklung von MPW-Shuttle- und Prototyping-Prozessen, insbesondere im Umfeld der Maskenerstellung und Auftragssteuerung.

### Leistungsumfang

Der Auftragnehmer erbringt insbesondere folgende Leistungen:

- Prüfung und Kontrolle von Kundendaten zur Maskengenerierung im Rahmen von MPW- und Prototyping-Services
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Koordination der Maskenerstellung
- Organisation und Steuerung der Auftragslogistik für MPW-Runs und Prototyping-Aufträge
- Planung und Koordination des Vereinzelns (Dicing) für jeden Run
- Organisation logistischer Abläufe für Wafer und ICs
- Kundenspezifisches bzw. projektspezifisches Dünnen von Wafern und ICs

- Vereinzelung (Dicing) von Wafern im Rahmen von Kundenprojekten und Forschungsprojekten
- 

## **Los 2: Backend-Prozessierung für MPW-Shuttle und Prototyping Services**

### **Leistungsgegenstand**

Durchführung und Unterstützung von Backend-Prozessen für Wafer und integrierte Schaltkreise im Rahmen von MPW- und Prototyping-Services.

### **Leistungsumfang**

Der Auftragnehmer erbringt insbesondere folgende Leistungen:

- Durchführung und Unterstützung von Backendprozessen für Wafer und ICs
  - Bereitstellung und Einsatz geeigneter Verpackungsmaterialien
  - Abdünnen von Wafern (Wafer Thinning Services)
  - Sägen (Dicing) von Wafern
  - Durchführung von Stealth Dicing Verfahren
- 

## **Los 3: Advanced Packaging, Cu-Pillar, Bumping und Qualitätssicherung**

### **Leistungsgegenstand**

Erbringung von Leistungen im Bereich Aufbau- und Verbindungstechnik sowie Packaging und qualitätssichernder Prüfprozesse.

### **Leistungsumfang**

Der Auftragnehmer erbringt insbesondere folgende Leistungen:

- Durchführung von Cu-Pillar-Prozessen
  - Solder Ball Bumping
  - Packaging von ICs
  - Durchführung von AOI (Automated Optical Inspection)
- 

### **Allgemeine Hinweise**

- Die Vergabe erfolgt im Rahmen einer Rahmenvereinbarung mit einer maximalen Gesamtlaufzeit von 48 Monaten.
- Die Beauftragung einzelner Leistungen erfolgt während der Vertragslaufzeit über Einzelabrufe (Call-offs).
- Es besteht kein Anspruch auf eine Mindestabnahmemenge.
- Die Lose werden unabhängig voneinander vergeben.
- Angebote können für ein oder mehrere Lose eingereicht werden.
- Die detaillierten Leistungspositionen je Los sind in den beigefügten Excel-Tabellen aufgeführt und Bestandteil der Ausschreibung.
- Die vollständig ausgefüllten Excel-Tabellen sind zwingender Bestandteil des Angebots. Unvollständige Angebote können ausgeschlossen werden.